

Dell EMC PowerEdge C6420

기술 사양

참고, 주의 및 경고

 **노트:** 참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.

 **주의:** 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

 **경고:** 경고는 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망 위험이 있음을 알려줍니다.

© 2017 - 2020 Dell Inc. 또는 자회사. 저작권 본사 소유. Dell, EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다. 다른 상표는 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

1 Dell EMC PowerEdge C6420 개요	4
2 기술 사양	5
Dell EMC PowerEdge C6420 슬레드 크기	5
새시 무게	5
프로세서 사양	6
지원되는 운영 체제	6
시스템 전지	6
확장 버스 사양	6
메모리 사양	6
드라이브 및 스토리지 사양	7
비디오 사양	7
환경 사양	7
표준 작동 온도 사양	8
확대된 작동 온도 사양	16
미세 먼지 및 가스 오염 사양	19
최대 진동 사양	19
최대 충격 사양	20
최대 고도 사양	20
Fresh Air 작동	20
3 설명서 리소스	21
4 도움말 얻기	23
Dell EMC에 문의하기	23
설명서에 대한 사용자 의견	23
QRL을 사용하여 시스템 정보에 액세스	23
C6400 및 C6420 시스템용 Quick Resource Locator	24
SupportAssist를 사용하여 자동화된 지원을 수신	24
재활용 또는 EOL(End-of-Life) 서비스 정보	24

Dell EMC PowerEdge C6420 개요

PowerEdge C6420 슬레드는 프로세서당 28개 코어를 포함하는 최대 2개의 인텔 제온 확장 가능 프로세서를 지원합니다. 또한, 이 슬레드는 확장 및 연결을 위한 OCP(Open Compute Project) 어댑터, PCIe 및 전용 메자닌을 지원합니다.

① 노트: 패브릭 커넥터가 지원되는 인텔 제온 확장 가능 프로세서는 **Native Omnipath**라고도 합니다.

기술 사양

이 섹션에는 시스템의 기술 및 환경 사양이 설명되어 있습니다.

주제:

- Dell EMC PowerEdge C6420 슬레드 크기
- 새시 무게
- 프로세서 사양
- 지원되는 운영 체제
- 시스템 전지
- 확장 버스 사양
- 메모리 사양
- 드라이브 및 스토리지 사양
- 비디오 사양
- 환경 사양

Dell EMC PowerEdge C6420 슬레드 크기

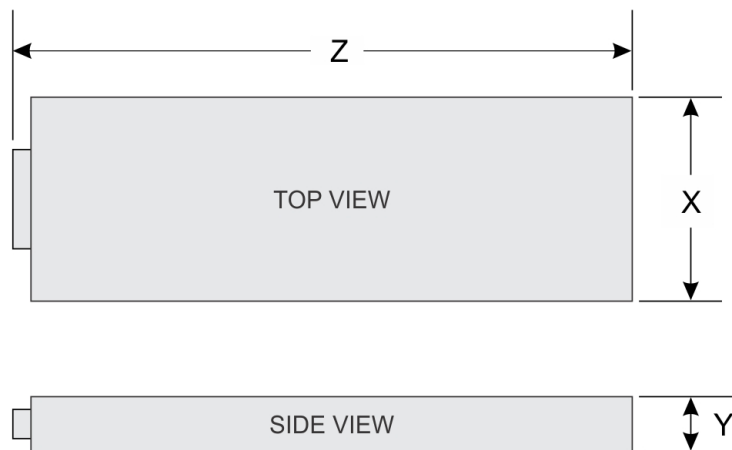


그림 1. PowerEdge C6420 슬레드 크기

표 1. PowerEdge C6420 슬레드 크기

X	Y	Z
174.4mm(6.86인치)	40.5mm(1.59인치)	574.5mm(22.61인치)

새시 무게

표 2. 슬레드가 있는 엔클로저의 새시 중량

시스템	최대 중량(모든 슬레드 및 드라이브 포함)
12개의 3.5" 하드 드라이브 시스템	43.62Kg(96.16lb)
백플레인 없는 시스템	34.56Kg(76.19lb)

프로세서 사양

Dell EMC PowerEdge C6420 슬레드는 4개의 독립 슬레드 각각에서 최대 2개의 인텔 제온 확장 가능 프로세서를 지원합니다. 각 프로세서는 최대 28개 코어를 지원합니다.

① 노트: 패브릭 프로세서는 패브릭 및 비패브릭 프로세서의 혼합 구성에서 프로세서 2 소켓에 설치되어야 합니다.

지원되는 운영 체제

Dell EMC PowerEdge C6420은 다음 운영 체제를 지원합니다.

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Microsoft Windows Server(Hyper-V 포함)
- Canonical Ubuntu LTS
- VMware ESXi
- Citrix XenServer

① 노트: 특정 버전 및 추가 사항에 대한 자세한 정보는 <https://www.dell.com/support/home/drivers/supportedos/poweredge-c6420>을 참조하십시오.

시스템 전지

PowerEdge C6420 슬레드는 CR 2032 3V 교체 가능 리튬 코인 셀 배터리를 사용합니다.

① 노트: 각 슬레드에 시스템 배터리가 있습니다.

확장 버스 사양

Dell EMC PowerEdge C6420 슬레드는 4개의 Gen 3 지원 PCIe 슬롯을 지원합니다.

표 3. 확장 버스 사양

PCIe 슬롯	설명	폼 팩터
x8 메자닌 PCIe 라이저	슬롯 1: 프로세서 1의 x8 PCIe Gen3	사용자 지정 폼 팩터
x8+x8 OCP 메자닌 라이저	슬롯 2: 프로세서 1의 x8 PCIe Gen3	표준 OCP(Open Compute Project) 폼 팩터
	슬롯 3: 프로세서 1의 x8 PCIe Gen3	
x16 PCIe 기본 라이저	슬롯 4: 프로세서 1의 x16 PCIe Gen3	표준 로우 프로파일 PCIe 폼 팩터
x16 내장 PCIe 라이저	슬롯 5: 프로세서 2의 x16 PCIe Gen3	사용자 지정 폼 팩터
		① 노트: M.2 SATA 라이저는 내장 라이저에서 지원됩니다.

메모리 사양

표 4. 메모리 사양

메모리 모듈 소켓	DIMM 유형	DIMM 랭크	DIMM 용량	단일 프로세서		듀얼 프로세서	
				최소 RAM	최대 RAM	최소 RAM	최대 RAM
288핀 16개	LRDIMM	4중 랭크	64GB	64GB	512GB	128GB	1024GB
		Octal 등급	128GB	128GB	1024GB	256GB	2048GB
	RDIMM	싱글 랭크	8GB	8GB	64GB	16GB	128GB
		듀얼 랭크	16GB	16GB	128GB	32GB	256GB
		32GB	32GB	256GB	64GB	512GB	

메모리 모듈 소켓	DIMM 유형	DIMM 랭크	DIMM 용량	단일 프로세서		듀얼 프로세서	
				최소 RAM	최대 RAM	최소 RAM	최대 RAM
			64GB	64GB	512GB	128GB	1024GB

드라이브 및 스토리지 사양

Dell EMC PowerEdge C6420 슬레드는 SAS 및 SATA 드라이브와 SSD(Solid State Drive)를 지원합니다.

표 5. PowerEdge C6420 슬레드에 대해 지원되는 드라이브 옵션

엔클로저에 장착 가능한 드라이브 최대 개수	슬레드당 할당 가능한 드라이브 최대 개수
12개의 8.89cm(3.5인치) 드라이브 시스템	슬레드당 3개의 SAS 또는 SATA 하드 드라이브와 SSD
24개의 6.35cm(2.5인치) 드라이브 시스템	슬레드당 6개의 SAS 또는 SATA 하드 드라이브와 SSD
NVMe를 포함하는 24개의 6.35cm(2.5인치) 드라이브 시스템	NVMe 백플레인 은 다음 구성 중 하나를 지원합니다. <ul style="list-style-type: none"> · 슬레드당 2개의 NVMe 드라이브 및 4개의 SAS 또는 SATA 드라이브와 SSD · 슬레드당 6개의 SAS 또는 SATA 하드 드라이브와 SSD
M.2 SATA 드라이브(선택 사항)	M.2 SATA 카드의 지원 용량은 최대 240GB입니다. 이 노트: M.2 SATA 카드는 x8(슬롯 1) 메자닌 라이저 또는 x16 라이저 슬롯(슬롯 5)에 설치할 수 있습니다.
부팅용 microSD 카드(선택 사항)(최대 64GB)	각 슬레드의 PCIe 라이저당 1개

표 6. M.2 SATA 드라이브와 함께 지원되는 RAID 옵션

옵션	RAID를 포함하지 않는 단일 M.2 SATA 드라이브	하드웨어 RAID를 포함하는 이중 M.2 SATA 드라이브
하드웨어 RAID	아니오	예
RAID 모드	N/A(해당 없음)	RAID 1
지원되는 드라이브의 수	1	2
지원되는 프로세서	프로세서 1	프로세서 1 및 프로세서 2

비디오 사양

Dell EMC PowerEdge C6420 슬레드는 16MB RAM을 탑재한 Matrox G200 통합형 그래픽 카드를 지원합니다.

표 7. 지원되는 비디오 해상도 옵션

해상도	재생률(hz)	색상 수준(비트)
1024 x 768	60	최대 24
1280 x 800	60	최대 24
1280 x 1024	60	최대 24
1360 x 768	60	최대 24
1440 x 900	60	최대 24

환경 사양

아래 섹션에는 시스템 환경 사양에 대한 정보가 나와 있습니다.

이 노트: 환경 인증에 대한 추가 정보는 www.dell.com/poweredgemanuals에서 매뉴얼 및 문서의 제품 환경 데이터시트를 참조하십시오..

표준 작동 온도 사양

이 노트:

1. 제공되지 않음: Dell EMC에서 제공되지 않는 구성임을 나타냅니다.
2. 지원되지 않음: 열 지원이 되지 않는 구성임을 나타냅니다.

이 노트: Mellanox DP LP 카드 및 인텔 Rush Creek 카드를 제외하고 주위 온도가 이 표에 나열된 최대 연속 운영 온도와 같거나 낮을 경우 충분한 열 마진으로 DIMM, 통신 카드, M.2 SATA 및 PERC 카드를 포함한 모든 구성 요소를 지원할 수 있습니다.

표 8. 표준 작동 온도 사양

표준 작동 온도	사양
온도 범위(950 m 또는 3117피트 미만의 고도에서)	장비가 직사광선을 받지 않는 상태에서 10°C~35°C(50°F~95°F)

이 노트: 일부 구성에는 보다 낮은 주위 온도가 필요합니다. 자세한 정보는 다음 표를 참조하십시오.

표 9. 비패브릭 듀얼 프로세서 구성에 대한 최대 연속 운영 온도

TDP(W)	프로세서 모델	방열판 모델	최대 메모리/프로세서	3.5" 새시			2.5" 새시					비 BP 새시 N/A(해당 없음)	
				12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	24개의 드라이브	20개의 드라이브	16개의 드라이브	12개의 드라이브	8개의 드라이브		4개의 드라이브
205W	8280	CPU1: FMM2M CPU2: V2DRD	CPU1: 6 CPU2: 8	지원되지 않음 (2°C)	지원되지 않음 (10°C)	지원되지 않음 (11°C)	지원되지 않음 (19°C)	20	21	21	21	21	30
	8280L	CPU1: FMM2M CPU2: V2DRD	CPU1: 6 CPU2: 8					20	21	21	21	21	30
	8280M	CPU1: FMM2M CPU2: V2DRD	CPU1: 6 CPU2: 8					20	21	21	21	21	30
	8270	CPU1: FMM2M CPU2: V2DRD	CPU1: 6 CPU2: 8					20	21	21	21	21	30
	8268	CPU1: FMM2M CPU2: V2DRD	CPU1: 6 CPU2: 8					20	21	21	21	21	30
200W	6254	CPU1: FMM2M CPU2: V2DRD	CPU1: 6 CPU2: 8	지원되지 않음 (6°C)	지원되지 않음 (14°C)	지원되지 않음 (15°C)	20	21	22	22	22	22	30
165W	8276	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	지원되지 않음 (11°C)	지원되지 않음 (18°C)	지원되지 않음 (19°C)	30	30	30	30	30	35	35
	8276L	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8				30	30	30	30	30	30	35

TDP(W)	프로세서 모델	방열판 모델	최대 메모리/프로세서	3.5" 새시			2.5" 새시						비 BP 새시		
				12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	24개의 드라이브	20개의 드라이브	16개의 드라이브	12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	N/A(해당 없음)		
	8276M	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8				30	30	30	30	30	35	35		
	8260	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8				30	30	30	30	30	30	35	35	
	8260L	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8				30	30	30	30	30	30	35	35	
	8260M	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8				30	30	30	30	30	30	35	35	
	8260C	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8				30	30	30	30	30	30	35	35	
150 W	6252	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	지원되지 않음 (14°C)			21	23	30	30	30	30	35	35	
	6248	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8				21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6240	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8				21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6242	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8				21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6244	CPU1: FMM2M CPU2: V2DRD	CPU1: 6 CPU2: 8				21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6240C	CPU1: FMM2M CPU2: V2DRD	CPU1: 6 CPU2: 8				21	23	30	30	30	30	30	35	35
125W	6230	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35		
	5220	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35		

TDP(W)	프로세서 모델	방열판 모델	최대 메모리/프로세서	3.5" 새시			2.5" 새시						비 BP 새시 N/A(해당 없음)
				12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	24개의 드라이브	20개의 드라이브	16개의 드라이브	12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	
		CPU2: V2DRD	CPU2: 8										
	5218	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	5218B	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	8253	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	6238T	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	6230N	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
115W	5217	CPU1: FMM2M CPU2: V2DRD	CPU1: 6 CPU2: 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
105W	5218T	CPU1: FMM2M CPU2: V2DRD	CPU1: 6 CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218N	CPU1: FMM2M CPU2: V2DRD	CPU1: 6 CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5222	CPU1: FMM2M CPU2: V2DRD	CPU1: 6 CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8256	CPU1: FMM2M CPU2: V2DRD	CPU1: 6 CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
100 W	4216	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
85W	5215	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

TDP(W)	프로세서 모델	방열판 모델	최대 메모리/프로세서	3.5" 새시			2.5" 새시						비 BP 새시 N/A(해당 없음)	
				12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	24개의 드라이브	20개의 드라이브	16개의 드라이브	12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브		
70W	5215M	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5215L	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4215	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214C	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4210	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4208	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	3204	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
70W	4209T	CPU1: JYKMM CPU2: V2DRD	CPU1: 8 CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

표 10. 비패브릭 단일 프로세서 구성에 대한 최대 연속 운영 온도

TDP(W)	프로세서 모델	방열판 모델	최대 메모리/프로세서	3.5" 새시			2.5" 새시						비 BP 새시 N/A(해당 없음)	
				12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	24개의 드라이브	20개의 드라이브	16개의 드라이브	12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브		
205W	8280	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35
	8280L	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35
	8280M	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35

TDP(W)	프로세서 모델	방열판 모델	최대 메모리/프로세서	3.5" 새시			2.5" 새시						비 BP 새시 N/A(해당 없음)	
				12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	24개의 드라이브	20개의 드라이브	16개의 드라이브	12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브		
	8270	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35
	8268	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35
200W	6254	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35
165W	6212U	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8276	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8276L	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8276M	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260L	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260M	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260C	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
150 W	6210U	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6252	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6248	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6240	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6242	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6244	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6240C	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
125W	6230	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5220	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218B	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

TDP(W)	프로세서 모델	방열판 모델	최대 메모리/프로세서	3.5" 새시			2.5" 새시						비 BP 새시 N/A(해당 없음)	
				12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	24개의 드라이브	20개의 드라이브	16개의 드라이브	12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브		
	8253	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6238T	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6230N	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
115W	5217	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
105W	5218T	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218N	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5222	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8256	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
100 W	4216	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
85W	5215	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5215M	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5215L	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4215	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214C	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4210	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4208	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	3204	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
70W	4209T	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

표 11. 활성(옵티컬) 연결을 포함하는 Mellanox Navi 듀얼 포트 카드 관련 구성 제한 사항

TDP(W)	3.5" 새시			2.5" 새시				비 BP 새시 N/A(해당 없음)
	12개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	24개의 HDD	16개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	
205W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	23

TDP(W)	3.5" 새시			2.5" 새시				비 BP 새시
	12개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	24개의 HDD	16개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	N/A(해당 없음)
200W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	23
173W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	24	24	28
165W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	24	25	25	26	29
160W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	24	25	26	26	30
150 W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	26	27	28	28	31
140W	지원되지 않음	23	25	28	29	29	30	33
135W	지원되지 않음	24	25	29	30	30	31	33
130 W	지원되지 않음	24	26	30	31	31	31	34
125W	20	25	27	30	31	32	32	35
115W	21	27	28	32	33	34	34	35 초과
113W	21	27	28	32	33	34	34	35 초과
105W	22	28	30	34	35	35 초과	35 초과	35 초과
85W	23	32	33	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과
70W	25	34	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과

표 12. 인텔 Rush Creek 구성 제한 사항

TDP(W)	3.5" 새시			2.5" 새시				비 BP 새시
	12개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	24개의 HDD	16개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	N/A(해당 없음)
205W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20	20	23
200W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	21	21	24
173W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20	20	23	24	28
165W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	22	22	24	25	29
160W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	22	22	24	26	29
150 W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	24	24	26	27	30
140W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	26	26	27	28	31
135W	지원되지 않음	지원되지 않음	20	26	26	28	29	32
130 W	지원되지 않음	지원되지 않음	20	27	27	29	29	33

TDP(W)	3.5" 새시			2.5" 새시				비 BP 새시 N/A(해당 없음)
	12개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	24개의 HDD	16개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	
125W	지원되지 않음	지원되지 않음	21	28	28	30	30	33
115W	지원되지 않음	21	23	29	31	31	32	34
105W	20	23	24	30	33	33	34	35 초과
85W	24	26	27	34	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과
70W	25	28	29	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과

표 13. 인텔 NVMe SSD AIC P4800X 구성 제한 사항

TDP(W)	3.5" 새시			2.5" 새시				비 BP 새시 N/A(해당 없음)
	12개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	24개의 HDD	16개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	
205W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
200W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
173W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20
165W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20
160W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	25
150 W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20	20	20	25
140W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20	20	20	20	25
135W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20	20	20	20	25
130 W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20	20	20	20	25
125W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20	25	25	25	30
115W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	25	25	25	25	30
105W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	25	25	25	25	30
85W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	30	30	30	30	35 초과
70W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과

확대된 작동 온도 사양

표 14. 확대된 작동 온도

확대된 작동 온도	사양
연속 작동	RH 5% ~ 85%에서 5°C ~ 40°C, 최대 이슬점 29°C 이 노트: 표준 운영 온도(10°C ~ 35°C)를 벗어나는 경우에도 시스템은 최저 5°C ~ 최고 40°C에서 연속 작동할 수 있습니다.
연간 작동 시간의 ≤ 1%	온도가 35°C ~ 40°C인 경우 허용되는 최대 건구 온도는 950m 이상의 고도에서 1°C/175m(1°F/319ft)씩 감소합니다. RH 5% ~ 90%에서 -5°C ~ 40°C, 최대 이슬점 29°C 이 노트: 표준 운영 온도(10°C ~ 35°C) 범위를 벗어나는 경우에도 연간 작동 시간의 최대 1% 동안 -5°C ~ 45°C에서 시스템을 작동할 수 있습니다. 온도가 40°C ~ 45°C인 경우 허용되는 최대 건구 온도는 950m 이상의 고도에서 1°C/125m(1°F/228ft)씩 감소합니다.

이 **노트:** 확대된 온도 범위에서 작동하는 경우 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

이 **노트:** 확대된 온도 범위에서 작동하는 경우 주위 온도 경고가 시스템 이벤트 로그에 보고될 수 있습니다.

작동 온도 정격 감소 사양

표 15. 작동 온도

운영 온도 정격 감소	사양
35°C(95°F) 이하	최대 온도는 950m(3,117ft) 이상에서 1°C/300m(1°F/547ft)씩 감소합니다.
35°C ~ 40°C(95°F ~ 104°F)	최대 온도는 950m(3,117ft) 이상에서 1°C/175m(1°F/319ft)씩 감소합니다.
45°C(113°F) 이상	최대 온도는 950m(3,117ft) 이상에서 1°C/125m(1°F/228ft)씩 감소합니다.

상대 습도 사양

표 16. 상대 습도 사양

상대 습도	사양
보관 시	최대 이슬점이 33°C(91°F)인 5% ~ 95% RH. 대기는 항상 비응축 상태여야 함.
작동 시	상대 습도 10% ~ 80%, 최대 이슬점 29°C(84.2°F).

온도 사양

표 17. 온도 사양

온도	사양
보관 시	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
연속 작동(950m 또는 3117ft 미만의 고도에서)	장비가 직사광선을 받지 않는 상태에서 10°C ~ 35°C(50°F ~ 95°F)

온도

사양

신선한 공기

신선한 공기에 관한 자세한 내용은 확대된 작동 온도 섹션을 참조하십시오.

최대 온도 변화(작동 및 보관 시)

20°C/h(68°F/h)

이 노트: 일부 구성에는 보다 낮은 주위 온도가 필요합니다. 자세한 내용은 **표준 운영 온도 사양**을 참조하십시오.

열 제한 사항

표 18. 이종 프로세서의 열 제한 매트릭스

최대 연속 작동 유입 온도(°C)													
				3.5" 새시			2.5" 새시						비 BP 새시
TDP(W)	프로세서 번호	CPU 방열판의 DPN	최대 DIMM 개수	12개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	24개의 HDD	20개의 HDD	16개의 HDD	12개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	N/A(해당 없음)
165W	6238R	CPU1: CPU2:	CPU1: 8 CPU2: 8	지원되지 않음			30	30	30	30	30	35	35
	6240R	CPU1: CPU2:	CPU1: 8 CPU2: 8	지원 되지 않음	지원되지 않음			30	30	30	30	30	35
150W	6230R	CPU1: CPU2:	CPU1: 8 CPU2: 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6226R	CPU1: CPU2:	CPU1: 8 CPU2: 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6208 U	CPU1: CPU2:	CPU1: 8 CPU2: 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
150W	5220 R	CPU1: CPU2:	CPU1: 8 CPU2: 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
130W	4215R	CPU1: CPU2:	CPU1: 8 CPU2: 8		25	25	30	30	35	35	35	35	35
125W	5218R	CPU1: CPU2:	CPU1: 8 CPU2: 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
100W	4214R	CPU1: CPU2:	CPU1: 8 CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35

최대 연속 작동 유입 온도(°C)														
	4210R	CPU1: 8 CPU2: 8	CPU1: 8 CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
95W	4210T	CPU1: CPU2:	CPU1: 8 CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
85W	3206R	CPU1: CPU2:	CPU1: 8 CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

표 19. 단일 프로세서의 열 제한 매트릭스

최대 연속 작동 유입 온도(°C)														
				3.5" 새시			2.5" 새시						비 BP 새시	
TDP(W)	프로세서 번호	CPU 방 열판의 DPN	최대 DIMM 개수	12개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	24개의 HDD	20개의 HDD	16개의 HDD	12개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	N/A(해당 없음)	
165W	6238R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6240R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
150W	6230R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6226R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6208U	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5220R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
130W	4215R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
125W	5218R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
100W	4214R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4210R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

최대 연속 작동 유입 온도(°C)													
95W	4210T	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
85W	3206R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

미세 먼지 및 가스 오염 사양

표 20. 미세 먼지 오염 사양

미세 먼지 오염	사양
공기 여과	데이터 센터 공기 여과는 ISO Class 8 per ISO 14644-1의 규정에 따라 95% 상위 지수 제한됩니다.
<p>이 노트: 이 조건은 데이터 센터 환경에만 적용됩니다. 공기 여과 요구사항은 사무실이나 공장 바닥과 같은 환경인 데이터 센터외 공간에서의 IT 장비에는 적용되지 않습니다.</p> <p>이 노트: 데이터 센터로 유입되는 공기는 MERV11 또는 MERV13 여과여야 합니다.</p>	
전도성 먼지	공기에는 전도성 먼지, 아연 휘스커, 또는 기타 전도성 입자가 없어야 합니다.
<p>이 노트: 이 조건은 데이터 센터 및 데이터 센터 외부 환경에 적용됩니다.</p>	
부식성 먼지	공기에는 부식성 먼지가 없어야 합니다.
<p>공기 내 잔여 먼지는 용해점이 60% 상대 습도 미만이어야 합니다.</p> <p>이 노트: 이 조건은 데이터 센터 및 데이터 센터 외부 환경에 적용됩니다.</p>	

표 21. 기체 오염 사양

기체 오염	사양
구리 쿠폰 부식률	ANSI/ISA71.04-2013의 규정에 따라 Class G1당 300Å/월 미만
은 쿠폰 부식률	ANSI/ISA71.04-2013의 규정에 따라 Class G1당 200Å/월 미만
<p>이 노트: ≤50% 상대 습도에서 측정된 최대 부식성 오염 수치</p>	

최대 진동 사양

표 22. 최대 진동 사양

최대 진동	사양
작동 시	5 Hz ~ 350 Hz에서 0.26Grms(모든 작동 방향)
보관 시	10 Hz ~ 500 Hz에서 15분 간 1.88Grms(6개 측면 모두 테스트)

최대 충격 사양

표 23. 최대 충격 사양

최대 충격	사양
작동 시	최대 11ms 동안 (+/-) x, y, z축으로 24회의 충격 펄스 6G(시스템 각 면에 4회의 펄스).
보관 시	최대 2ms 동안 (+/-) x, y, z축으로 6회의 연속 충격 펄스 71G(시스템 각 면에 1회의 펄스).

최대 고도 사양

표 24. 최대 고도 사양

최대 고도	사양
작동 시	3048m(10,000ft)
보관 시	12,000m(39,370ft).

Fresh Air 작동

Fresh Air 작동 제한 사항

- TDP가 105W를 넘는 프로세서 지원 안 됨
- PERC 제한 사항이 없는 85W 이하의 프로세서 지원
- 8.89cm(3.5인치) 드라이브 구성 지원 안 됨
- CPU1 소켓의 프로세서에 114mm 방열판 필요
- Kerby-flat OCP 지원 안 됨
- DCS 메자닌 슬롯에 M.2 카드 지원 안 됨
- NVMe SSD 지원 안 됨
- AEP DIMM 및 LRDIMM 지원 안 됨
- 25W를 넘는 PCIe 카드 지원 안 됨
- H730 PERC 및 H330의 105W 프로세서 지원
- 85W 이하 TDP 프로세서에 PERC 제한 없음

설명서 리소스

이 섹션은 시스템의 설명서 리소스에 대한 정보를 제공합니다.

문서 자료 리소스 표에 나열된 문서를 보려면 다음을 수행하십시오.

- Dell EMC 지원 사이트:
 1. 표의 위치 열에 있는 문서 자료 링크를 클릭합니다.
 2. 필요한 제품 또는 제품 버전을 클릭합니다.
 - ① **노트: 제품 이름 및 모델을 찾으려면 시스템의 전면을 참조하십시오.**
 3. 제품 지원 페이지에서 **매뉴얼 및 문서**를 클릭합니다.
- 검색 엔진 사용:
 - 검색 상자에 문서 이름 및 버전을 입력합니다.

표 25. 시스템에 대한 추가 설명서 리소스

작업	문서	위치
시스템 설정	랙에 시스템을 설치하고 고정하는 방법에 대한 자세한 정보는 랙 솔루션과 함께 제공되는 랙 설치 가이드를 참조하십시오. 시스템 설정에 대한 정보는 시스템과 함께 제공되는 <i>시작 가이드</i> 문서를 참조하십시오.	www.dell.com/poweredgemanuals
시스템 구성	iDRAC 기능, iDRAC 구성 및 로그인, 원격 시스템 관리에 대한 정보는 Integrated Dell Remote Access Controller 사용 가이드를 참조하십시오. RACADM(Remote Access Controller Admin) 하위 명령 및 지원되는 RACADM 인터페이스 이해에 대한 자세한 정보는 iDRAC용 RACADM CLI 가이드를 참조하십시오. Redfish 및 해당 프로토콜, 지원되는 스키마, iDRAC에 구현된 Redfish 이벤트에 대한 정보는 Redfish API 가이드를 참조하십시오. iDRAC 속성 데이터베이스 그룹 및 객체 설명에 대한 자세한 내용은 속성 레지스트리 가이드를 참조하십시오.	www.dell.com/poweredgemanuals
	이전 버전의 iDRAC 문서에 대한 자세한 정보는 iDRAC 문서 자료를 참조하십시오. 시스템에서 사용할 수 있는 iDRAC의 버전을 식별하려면 iDRAC 웹 인터페이스에서 ? > About 을 클릭합니다.	www.dell.com/idracmanuals
	운영 체제를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 운영 체제 설명서를 참조하십시오.	www.dell.com/operatingsystemmanuals
시스템 관리	Dell에서 제공하는 시스템 관리 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 Dell OpenManage 시스템 관리 개요 가이드를 참조하십시오.	www.dell.com/poweredgemanuals
	OpenManage 설정, 사용, 문제 해결에 대한 자세한 내용은 Dell OpenManage Server Administrator 사용 가이드를 참조하십시오.	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Server Administrator

작업	문서	위치
	Dell OpenManage Essentials 설치, 사용, 문제 해결에 대한 자세한 내용은 Dell OpenManage Essentials 사용 가이드를 참조하십시오.	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Essentials
	Dell OpenManage Enterprise 설치, 사용, 문제 해결에 대한 정보는 Dell OpenManage Enterprise 사용자 가이드를 참조하십시오.	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Enterprise
	Dell SupportAssist 설치 및 사용에 대한 정보는 Dell EMC SupportAssist Enterprise 사용자 가이드를 참조하십시오.	https://www.dell.com/serviceabilitytools
	파트너 프로그램 엔터프라이즈 시스템 관리에 대한 자세한 내용은 OpenManage Connections 엔터프라이즈 시스템 관리 설명서를 참조하십시오.	www.dell.com/openmanagemanuals
Dell PowerEdge RAID 컨트롤러 작업	Dell PowerEdge PERC(PowerEdge RAID Controllers), 소프트웨어 RAID 컨트롤러 또는 BOSS 카드의 기능 이해 및 카드 배포에 대한 정보는 스토리지 컨트롤러 문서 자료를 참조하십시오.	www.dell.com/storagecontrollermanuals
이벤트 및 오류 메시지 이해	시스템 구성 요소를 모니터링하는 시스템 펌웨어 및 에이전트에서 생성된 이벤트 및 오류 메시지에 대한 정보는 Error Code Lookup 페이지를 참조하십시오.	www.dell.com/qrl
시스템 문제 해결	PowerEdge 서버 문제를 식별하여 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 서버 문제 해결 가이드를 참조하십시오.	www.dell.com/poweredgemanuals

도움말 얻기

주제:

- Dell EMC에 문의하기
- 설명서에 대한 사용자 의견
- QRL을 사용하여 시스템 정보에 액세스
- SupportAssist를 사용하여 자동화된 지원을 수신
- 재활용 또는 EOL(End-of-Life) 서비스 정보

Dell EMC에 문의하기

Dell EMC는 다양한 온라인 및 전화 기반의 지원 및 서비스 옵션을 제공합니다. 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 구매 송장, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell EMC 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 확인할 수 있습니다. 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell EMC에 문의하려면

단계

1. www.dell.com/support/home 페이지로 이동합니다.
2. 페이지 우측 하단에 있는 드롭다운 메뉴에서 국가를 선택합니다.
3. 맞춤형 지원:
 - a) **Enter your Service Tag(서비스 태그 입력)** 필드에 시스템 서비스 태그를 입력합니다.
 - b) **제출**을 클릭합니다.
여러 가지 지원 범주가 나열되어 있는 지원 페이지가 표시됩니다.
4. 일반 지원:
 - a) 제품 범주를 선택합니다.
 - b) 제품 세그먼트를 선택합니다.
 - c) 제품을 선택합니다.
여러 가지 지원 범주가 나열되어 있는 지원 페이지가 표시됩니다.
5. Dell EMC 전역 기술 지원에 대한 연락처 세부 정보를 보려면
 - a) **전역 기술 지원**을 클릭합니다.
 - b) Dell EMC 전역 기술 지원팀의 전화, 채팅 또는 이메일에 대한 세부 정보가 포함된 **기술 지원에 문의** 페이지가 표시됩니다.

설명서에 대한 사용자 의견

Dell EMC 설명서 페이지에서 설명서를 평가하거나 **Send Feedback(피드백 보내기)**을 클릭해 피드백을 남길 수 있습니다.

QRL을 사용하여 시스템 정보에 액세스

PowerEdge R930 전면의 정보 태그에 있는 QRL(Quick Resource Locator)을 사용하여 PowerEdge R930에 대한 정보에 액세스할 수 있습니다.

전제조건

스마트폰 또는 태블릿에 QR 코드 스캐너가 설치되어 있는지 확인합니다.

QRL에는 시스템에 대한 다음 정보가 포함되어 있습니다.

- 방법 동영상
- 설치 및 서비스 매뉴얼, 및 기계 개요를 포함한 참조 자료
- 특정 하드웨어 구성 및 보증 정보에 빠르게 액세스하기 위한 시스템 서비스 태그
- 기술 지원 및 영업팀에 직접 연락할 수 있는 Dell 링크

단계

1. www.dell.com/qrl 페이지로 이동하여 특정 제품을 탐색하거나
2. 스마트폰 또는 태블릿을 사용하여 시스템 또는 QRL 섹션에서 모델별 QR(Quick Resource) 코드를 스캔합니다.

C6400 및 C6420 시스템용 Quick Resource Locator



그림 2 . PowerEdge C6400 및 C6420 시스템용 Quick Resource Locator

SupportAssist를 사용하여 자동화된 지원을 수신

Dell EMC SupportAssist는 Dell EMC 서버, 스토리지 및 네트워킹 디바이스에 대한 기술 지원을 자동화하는 Dell EMC Services(옵션)입니다. SupportAssist 애플리케이션을 IT 환경에 설치 및 설정하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

- **자동 문제 감지** - SupportAssist는 Dell EMC 디바이스를 모니터링하고 하드웨어 문제를 사전 예방적으로 예측하여 자동으로 감지합니다.
- **자동 케이스 생성** - 문제가 감지되면 SupportAssist가 Dell EMC 기술 지원으로 지원 케이스를 자동으로 엽니다.
- **자동 진단 수집** - SupportAssist는 디바이스에서 자동으로 시스템 상태 정보를 수집하고 Dell EMC에 안전하게 업로드합니다. Dell EMC 기술 지원에서 이 정보를 사용하여 문제를 해결합니다.
- **사전 예방적 연락** - Dell EMC 기술 지원 에이전트가 지원 케이스에 대해 연락하고 문제를 해결할 수 있도록 도와드립니다.

제공되는 이점은 디바이스에 대해 구매한 Dell EMC Service 사용 권한에 따라 다릅니다. SupportAssist에 대한 자세한 정보는 www.dell.com/supportassist로 이동하십시오.

재활용 또는 EOL(End-of-Life) 서비스 정보

특정 국가에서 이 제품에 대한 회수 및 재활용 서비스가 제공됩니다. 시스템 구성 요소를 폐기하려면 www.dell.com/recyclingworldwide 페이지를 방문하여 해당 국가를 선택하십시오.